



NEWS RELEASE

報道資料
2008年4月8日
(日本時間)

アプライド マテリアルズ 2,500 台目の CMP 装置を出荷、
10 年間にわたって CMP 分野でリーダーシップを発揮

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼 CEO マイケル・スプリンター) は 4 月 4 日 (現地時間)、通算 2,500 台目の CMP 装置を出荷し、アプライド マテリアルズが CMP 分野で 10 年間にわたってリーダーシップを維持していることを改めて示しました。アプライド マテリアルズの CMP 装置は大手半導体メーカーの大半で採用され、ロジックおよびメモリーデバイスの最先端技術への移行を数世代にわたって支えています。300mm 工場に設置されているアプライド マテリアルズの CMP 装置の設置台数はこの 2 年足らずで倍増し、1,000 台近くとなりました。その中でも最多を占めているのが、最先端の CMP プラットフォーム Applied Reflexion® LK です。

アプライド マテリアルズの CMP 部門ジェネラルマネージャー、ラクシュマナン・カルーピアは次のように述べています。「アプライド マテリアルズは 2,500 台の CMP 装置を通じて銅ダマシ、STI、酸化膜、ポリシリコン膜、タングステン膜などの難しい CMP 課題に対するソリューションを半導体メーカーに提供してきました。アプライド マテリアルズの Reflexion LK は、ロジックデバイスの銅配線の平坦化ですでに主導的な役割を果たしていますが、現在では複数のメモリーメーカーでアルミ配線から銅配線への量産移行を支援するとともに、製品投入サイクルの短縮に役立っています」

アプライド マテリアルズは、業界で最も厳密なプロセス制御と最も効率的なウェーハ洗浄技術、世界トップクラスの平坦化性能を通じて自社の CMP 装置を差別化し、歩留まり向上とチップコストの大幅な低減を実現しています。Reflexion LK に組み込まれている Desica®洗浄装置は、独自の Marangoni™ベーパー乾燥技術によって残渣のないポスト洗浄性能を確保し、欠陥低減を図っています。この装置は 3 つの高速平坦化プラテンとマルチゾーンの Titan Contour™研磨ヘッドによってウェーハ面内の均一性を高め、あらゆる CMP アプリケーションのスループットを向上させます。

アプライド マテリアルズは昨年、45nm ノード以降に対応した in-situ 終点検出装置 FullVision™ を投入し、絶縁膜 CMP のリアルタイムプロセス制御機能をさらに強化しま

した。FullVision は特許の window-in-pad 技術を多波長分光技術と組み合わせることにより、消耗品セットのドリフトと投入ウェーハのプロファイルばらつきによるウェーハ廃棄を最小限に抑えて高い CMP 歩留まりを実現しています。

アプライド マテリアルズは、Nanomanufacturing Technology™ ソリューションのグローバルリーダーとして、半導体デバイス、フラットパネルディスプレイ、太陽電池などの製造装置ならびに、サービス、ソフトウェア製品を幅広く提供し、ナノマニュファクチャリングテクノロジーを人々のライフスタイル向上に役立てています。

詳しい情報はホームページ：http://www.appliedmaterials.com/news/index_6.html（日本語）でもご覧いただけます。

このリリースは 4 月 4 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:渡辺徹)は 1979 年 10 月に設立。大阪支店ほか 15 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社
〒108-8444 港区海岸 3-20-20 ヨコソーレインボータワー
コーポレート マーケティング部 : 平澤 美香 (Tel: 03-6812-6807 / Fax: 03-6812-6833)
ホームページ: <http://www.appliedmaterials.com>
